



勢流科技

partner

SIEMENS

Digital Industries Software



Simcenter Flotherm What's New in 2310



Jf.li



CAE工程師



Jf.li@flotrend.com.tw



IC 封裝 Compact model 的 embeddable BCI-ROM

Challenge:

IC 封裝的 Detail 模型可能會暴露 know How，以及標準 Compact 模型不支援瞬態模擬或多熱源模擬。

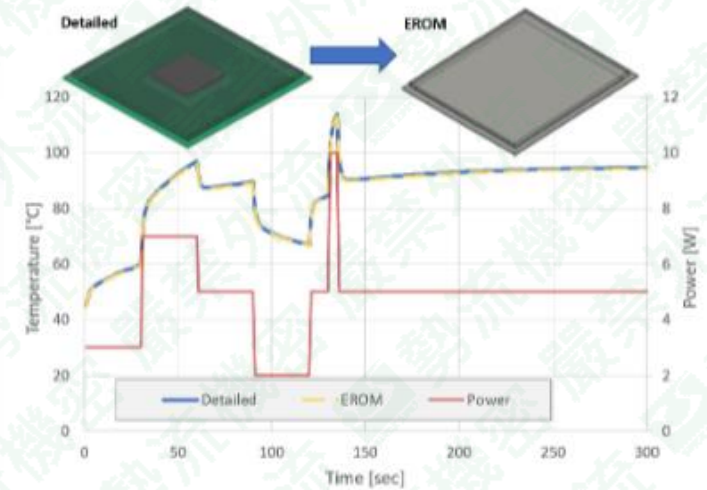
可以被信任的模型支援電子模擬供應鏈

Solution:

將 embeddable BCI-ROM 導入 Simcenter Flotherm。

Benefits:

- 無法進行逆向的模型解析
- 在所有情況下，預測準確性可與 DELPHI 模型相同，包括：
 1. 瞬態模擬
 2. 支援多晶片封裝
- 可以提升求解速率



| Model | BCI? | Transient? | Multiple Heat Sources? | IP Protected? |
|----------|------|------------|------------------------|---------------|
| 2R | No | No | No | Yes |
| DELPHI | Yes | No | No | Yes |
| Detailed | Yes | Yes | Yes | No |
| BCI-ROM | Yes | Yes | Yes | Yes |





欲知詳情，請加入勢流會員
即可每月收到會員電子報

